

## < 参加者募集 >

### 日米半導体プログラム UPWARDS に基づく 米国 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 2026 夏期滞在

夏休みに米国ニューヨーク州にある Rensselaer Polytechnic Institute (RPI : <https://www.rpi.edu/>) に約2週間滞在し、自身の研究内容を議論しながら半導体について学ぶプログラムを実施します。参加を希望する方は、応募フォームから応募してください。滞在中の学費と経費は九大の旅費規程に則り、UPWARDS の寄附金で賄われる予定です。

Micron 財団および東京エレクトロンご支援の下、半導体人材育成を目的とした日米 UPWARDS (※) のプログラムを行っています。このプログラムには、日本の5大学（東北大、東京科学大、名古屋大、広島大、九州大）と米国6大学（University of Washington、Purdue University、Rochester Institute Technology、Rensselaer Polytechnic Institute、Virginia Tech、Boise State University）が参画しています。

#### 記

- ・日程 : 2026年8月1日(土)～8月17日(月)
- ・場所 : Rensselaer Polytechnic Institute's main campus in Troy, NY
- ・内容 : 半導体セミナー、クリーンルーム施設での実験、他。
- ・対象者 : 電気情報工学科2年～博士課程学生。電気工学、応用物理学、情報科学またはコンピュータサイエンス分野の基礎科目を修了していること。  
応募者が多い場合は志望動機・面接等で選抜。女子の参加を強く推奨します。
- ・人数 : 2名
- ・滞在 : RPI 学生寮
- ・参加費 : ESTA 取得費用、海外旅行保険料及びプログラムに含まれない現地食事代・課外活動費用については、参加者負担とする。  
なお、渡航のための航空券代及び宿泊費用は大学負担とする。
- ・募集期限 : 2026年2月25日(水) **2026年3月9日(月)**
- ・応募 URL : <https://forms.gle/LBXBGyuUk2hDxYqE8>



- ・問合先 : システム情報科学研究所 湯浅 (hiromi.yuasa@ed.kyushu-u.ac.jp)  
UPWARDS 事務局 (upwards@mag.ed.kyushu-u.ac.jp)